

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路制造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零四年九月三十日止三個月業績公佈

本公司謹於今日公佈截至二零零四年九月三十日止三個月的未經審核經營業績。

- 銷售額由上季的 221,000,000 元增至二零零四年第三季的 274,900,000 元，增幅 24.4%。
- 經營溢利由上季的 36,400,000 元增至二零零四年第三季的 42,500,000 元，增幅 16.9%。
- 普通股持有人應占收入增至 39,300,000 元，較二零零四年第二季 34,200,000 元上升 15.2%。
- 較 2004 年第二季，晶圓付運增加 30.9%至 263,808 片 8 吋等值晶圓。

以下為本公司於二零零四年十月二十八日就截至二零零四年九月三十日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。

• 由於本公司於二零零四年十月二十八日在美國作出報章公佈(現轉載如下)，因此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條規定的披露責任而作出本公佈。

以下為本公司於二零零四年十月二十八日就截至二零零四年九月三十日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數位均以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中芯二零零四年第三季業績報告

概要

- 銷售額增至 274,900,000 元，較二零零四年第二季 221,000,000 元上升 24.4%。
- 經營溢利增至 42,500,000 元，較二零零四年第二季 36,400,000 元上升 16.9%。

- 普通股持有人應占收入增至 39,300,000 元，較二零零四年第二季 34,200,000 元上升 15.2%。
- 較 2004 年第二季晶圓付運增加 30.9%至 263,808 片 8 吋等值晶圓。
- 每股基本盈利——每股普通股 0.0022 元（港幣元 0.0170⁽¹⁾），每股美國預托股 0.1095 元。
- 每股攤薄盈利——每股普通股 0.0022 元（港幣元 0.0170⁽¹⁾），每股美國預托股 0.1079 元。

中國上海—二零零四年十月二十八日—國際主要半導體承包製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零四年九月三十日止三個月的綜合經營業績。二零零四年第三季銷售額由上一季度的 221,000,000 元增加 24.4%至 274,900,000 元。二零零四年第三季經營溢利由上一季度的 36,400,000 元增加 16.9%至 42,500,000 元。

本公司報告普通股持有人應占收入增至 39,300,000 元，較二零零四年第二季 34,200,000 元上升 15.2%相當於每股普通股 0.0022 元（港幣元 0.0170⁽¹⁾）及每股美國預托股 0.1095 元按全面攤薄基準計算則為每股普通股 0.0022 元（港幣 0.0170 元⁽¹⁾）及每股美國預托股 0.1079 元。

附注：(1) 根據二零零四年十月二十五日的終結匯率，7.7774 港幣=1 美元（來源：Bloomberg）。

“我們高興地報告2004年第三季業績繼續成長”，中芯國際總裁兼總執行長張汝京先生說：“在2004年第三季中，我們獲得了26家新客戶，其中7家是中國的無廠房公司。大中國區域在全部營收中表現有力，占到了6.6%的份額。新客戶為我們第三季的產能利用率達到99%做出了有力的貢獻。我們從各個類型市場的客戶那裏都得到相對強勁的訂單，尤其是在通訊類產品市場的客戶。中國內地第一個12英寸晶圓代工廠，中芯國際4廠在2004年9月25日在北京舉行了正式開業典禮。4廠產能將按計劃逐漸攀升，並計劃於2004年第四季開始量產。我們相信隨著我們的營業計劃不斷進展，不斷達到新技術里程碑，我們將為股東的利益奠定未來成長和發展的堅實基礎。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零四年十月二十八日

時間：上海時間下午八時正

撥號及登入密碼：美國 1-617-847-8711（密碼：SMIC）或香港 852-3002-1672（密碼：SMIC）。

二零零四年第三季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

有關中芯

中芯（紐約交易所：SMI；香港聯交所：0981.HK）是全球首屈一指的半導體承包製造廠之一。作為一家半導體承包製造廠，中芯提供以 0.35 微米至 0.13 微米技術製造的集成電路。中芯成立於二零零零年四月，是一家開曼群島公司，於中國上海張江高科技園區營運三間 8 吋晶圓裝配廠，以及於天津營運一間 8 吋晶圓裝配廠。此外，中芯最近在中國北京的新 12 吋晶圓裝配廠房開始試產。為向客戶提供高品質的服務，中芯國際還營運在美國、歐洲、日本的客戶服務和市場銷售辦公室。中芯國際努力達到甚至超越各項國際標準並已獲得 ISO9001, ISO/TS16949, OHSAS18001 和 ISO14001 國際認證。其他資料詳情，請瀏覽 www.smics.com。

安全港聲明

（根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據 1995 私人有價證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，為并非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體承包製造服務供求情況、市場產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零四年三月十一日以 F-1 表格（經修訂）形式呈交予證交會的登記聲明，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份、其於二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港聯合交易所（「香港聯交所」）的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可逆料的因素亦可能會

對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則本新聞發佈日期）的情況而表述。

除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

投資者聯絡資料：

Jimmy Lai

投資者關係部負責人

電話：86-21-5080-2000，內線 16088

傳真：86-21-5080-3070

Calvin Lau

投資者關係部

電話：86-21-5080-2000，內線 16693

傳真：86-21-5080-3070

Evonne Hwang

投資者關係部

電話：86-21-5080-2000，內線 16275

傳真：86-21-5080-3070

概要：

以千美元為單位（每股盈利除外）

	<u>二零零四年</u> <u>第三季度</u>	<u>二零零四年</u> <u>第二季度</u>	<u>季度比較</u>	<u>二零零三年</u> <u>第三季度</u>	<u>年度比較</u>
銷售	274,897	220,988	24.4%	107,141	156.6%
銷售成本	(202,387)	(159,507)	26.9%	(96,768)	109.1%
毛利	72,510	61,481	17.9%	10,373	599.0%
經營開支	(29,972)	(25,091)	19.5%	(21,502)	39.4%
經營溢利	42,538	36,390	16.9%	(11,129)	-
其他收入	(3,195)	(2,225)	43.6%	2,673	-
收入淨額	39,343	34,165	15.2%	(8,456)	-
未發盈餘	-	-	-	(34,586)	-
普通股持有人應占收入	39,343	34,165	15.2%	(43,042)	-
毛利率	26.4%	27.8%		9.7%	
經營利潤率	15.5%	16.5%		-10.4%	
每股基本盈利－每股普通股 1)	\$0.0022	\$0.0019		(\$0.4625)	
每股基本盈利－每股美國預托股份	\$0.1095	\$0.0955		(\$23.1237)	
每股攤薄盈利－每股普通股	\$0.0022	\$0.0019		(\$0.4624)	
每股攤薄盈利－每股美國預托股份	\$0.1079	\$0.0941		(\$23.1237)	
付運晶圓（千片 8 吋等值）(2)	263,808	201,534	30.9%	130,780	101.7%
綜合平均售價	\$991	\$1,034	-4.2%	\$771	28.5%
邏輯平均售價(3)	\$1,091	\$1,089	0.2%	\$883	23.6%
產能使用率	99%	99%		93%	

附注：

(1) 基於二零零四年第三季加權平均普通股 17,961,000,000 股和二零零四年第二季 17,897,000,000 股。

(2) 包括銅接連件

(3) 不包括銅接連件

- 銷售額增至 274,900,000 元，較二零零四年第二季的 221,000,000 元錄得季度升幅 24.4%，並較二零零三年第三季的 107,100,000 元錄得年度升幅 156.6%。導致此等上升的主要因素如下：

- 二零零四年第三季末產能增加至 99,043 片 8 吋晶圓；

- 晶圓付運增至 263,808 片，較二零零四年第二季的 201,534 片錄得季度升幅 30.9%；
- 99%的高使用率
- 銷售成本從上季的 159,500,000 元增加到 202,400,000 元，主要由於晶圓付運增加。
- 毛利增至 72,500,000 元，較二零零四年第二季的 61,500,000 元錄得季度升幅 17.9%並較二零零三年第三季的 10,400,000 元錄得年度升幅 599%。
- 研發費用增加至 20,700,000 元，較上季的 13,500,000 元上升 52.9%，主要來自北京四廠非經常性工程開業成本以及 90 納米的研究開發活動。
- 一般行政費用從二零零四年第二季 6,000,000 元減少 36.3%至 3,800,000 元，差額主要因與經營活動（如應收賬款或應付賬款）相關的匯兌收益 6,500,000 元。
- 二零零四年第三季度銷售及市場推廣費用稍稍下降至 1,900,000 元。
- 經營溢利增至 42,500,000 元，較二零零四年第二季的 36,400,000 元錄得季度升幅 16.9%，二零零三年第三季則為虧損 11,100,000 元。
- 其他非營業性虧損增加至 3,200,000 元，較二零零四年第二季的 2,200,000 元上升 43.6%，主要是因與融資或投資活動（如遠期合約歸類為其他業務收入/支出）相關的非經營性活動產生的匯兌損失 3,600,000 元。
- 二零零四年第三季利息收入增加至 3,100,000 元，主要由於利率上升增加了利息收入所致。
- 淨收入增至 39,300,000 元，較二零零四年第二季的 34,200,000 元錄得季度升幅 15.2%，二零零三年第三季則為虧損 8,500,000 元。

1. 收入分析

銷售分析					
以應用分類	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三 年第四季	二零零三年 第三季
電腦	20.5%	22.5%	25.1%	26.7%	33.3%
通訊	57.2%	54.3%	56.0%	55.8%	48.2%
消費	17.1%	17.1%	12.7%	13.5%	11.7%
其他	5.2%	6.1%	6.2%	4.0%	6.8%
以裝置分類	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三 年第四季	二零零三年 第三季
邏輯（僅包括銅接連件）	77.6%	73.5%	72.4%	71.6%	60.0%
記憶體	17.5%	20.8%	21.6%	24.5%	34.0%
其他（光罩製造及探測）	4.9%	5.7%	6.0%	3.9%	6.0%
以客戶類別分類	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三 年第四季	二零零三年 第三季
非廠房半導體公司	35.3%	36.1%	36.6%	30.8%	31.1%
集成裝置製造商	56.3%	54.8%	54.0%	62.7%	49.2%
系統公司及其它	8.4%	9.1%	9.4%	6.5%	19.7%
以地區分類	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三 年第四季	二零零三年 第三季
北美洲	41.8%	44.0%	41.4%	36.2%	38.8%
亞太區（不包括日本）	31.5%	26.5%	27.2%	28.6%	38.2%
日本	15.6%	16.2%	16.3%	15.5%	13.3%
歐洲	11.1%	13.3%	15.1%	19.7%	9.7%
晶圓收入分析					
以技術分類 （僅包括邏輯、記憶及銅連接件）	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三 年第四季	二零零三年 第三季
0.13 痠	11.9%	9.9%	10.1%	10.4%	15.0%
0.15 痠	13.2%	13.3%	15.7%	17.5%	10.0%
0.18 痠	46.2%	48.6%	44.4%	34.7%	19.7%
0.25 痠	6.4%	8.3%	8.3%	10.6%	33.7%
0.35 痠	22.3%	19.9%	21.5%	26.8%	21.6%

以邏輯分類(1)	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三 年第四季	二零零三年 第三季
0.13 瘦	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
0.15 瘦	4.6%	3.9%	4.4%	1.9%	0.3%
0.18 瘦	56.2%	63.0%	58.5%	52.9%	40.3%
0.25 瘦	6.1%	3.1%	5.0%	3.4%	15.1%
0.35 瘦	31.3%	29.1%	32.1%	41.8%	44.3%

附注：

(1) 不包括 0.13 瘦銅接連件

- 相較二零零四年第二季而言，二零零四年第三季通訊類別的銷售額較其他應用技術增長更快。
- 二零零四年第三季邏輯晶圓(包括銅接連件) 的銷售百分比上升至占銷售額達 77.6%，二零零四年第二季及二零零三年第三季度則分別為 73.5%及 60.0%。
- 集成裝置製造商占二零零四年第三季銷售額 56.3%，二零零四年第二季則為 54.8%。
- 二零零四年第三季源自亞太客戶（不包括日本）的銷售百分比上升至 31.5%，二零零四年第二季度則為 26.5%，上升主要原因是由於大中華地區占了二零零四年第三季銷售總額的 6.6%。
- 二零零四年第三季 0.18 瘦及以下技術的銷售百分比仍保持占銷售額達 71.3%，二零零四年第二季及二零零三年第三季度則分別為 71.8%及 44.7%。

產能：

期終每月晶圓計，8 吋等值

廠／(晶圓尺寸)	二零零四年第三季	二零零四年第二季
一廠(8吋)	38,820	33,675
二廠(8吋)	34,824	31,098
七廠(8吋)	10,322	6,000
每月晶圓裝配總產能	83,966	70,773

銅接連件：		
三廠（8吋）	15,077	10,099
每月銅接連件總產能	15,077	10,099

* 截至二零零四年第三季度終結時，由於本公司不斷提升一、二、三廠及七廠的沖次表現，每月產能增加至 99,043 件晶圓。

付運及使用率：

8吋晶圓	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季	二零零四年 第一季	二零零三年 第四季	二零零三年 第三季
付運晶圓（包括銅接連件）	263,808	201,534	174,325	153,125	130,780
使用率 ⁽¹⁾	99%	99%	99%	97%	93%

附注：

(1) 使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零四年第三季晶圓付運量為 263,808 件 8 吋晶圓，分別較二零零四年第二季的 201,534 片及二零零三年第三季度的 130,780 片上升 30.9%及 101.7%。
- 使用率保持在 99%。

綜合平均售價趨勢

邏輯平均售價趨勢（不包括 0.13 瘦銅接連件）

二零零四年第三季綜合平均售價分別由二零零四年第二季的 1,034 元下降至 991 元，對二零零三年第三季度的 771 元而言有所上升。主要原因在於本公司轉而生產更多成熟的邏輯晶圓。

二零零四年第三季邏輯平均售價（不包括 0.13 瘦銅接連件）分別由二零零四年第二季及二零零三年第三季度的 1,089 元及 883 元上升至 1,091 元。主要原因在於本公司生產更多的 0.15 瘦和以下的邏輯晶圓，並採納更先進的處理技術，以及本公司在市場上建立了地位。

2. 詳細財務分析

毛利分析

<u>以千美元計</u>	<u>二零零四年</u> <u>第三季</u>	<u>二零零四年</u> <u>第二季</u>	<u>季度比較</u>	<u>二零零三年</u> <u>第三季</u>	<u>年度比較</u>
銷售成本	(202,387)	(159,507)	26.9%	(96,768)	109.1%
折舊和攤銷	(108,214)	(83,990)	28.8%	(47,476)	127.9%
其他製造成本	(94,173)	(75,517)	24.7%	(49,292)	91.1%
毛利	72,510	61,482	17.9%	10,373	599.0%
毛利率	26.4%	27.8%		9.7%	

- 銷售成本從上季的 159,500,000 元增長 26.9%至 202,400,000 元，主要是由於晶圓付運增加。
- 毛利增至 72,500,000 元，較二零零四年第二季的 61,500,000 元錄得季度升幅 17.9%，二零零三年第三季的 10,400,000 元錄得年度升幅 599.0%。
- 毛利率從二零零四年第二季的 27.8%降至 26.4%，主要是本公司通過提高生產效率而抵消了 ASP 下降了 4.2%的影響。

經營開支分析

<u>以千美元計</u>	<u>二零零四年</u> <u>第三季</u>	<u>二零零四年</u> <u>第二季</u>	<u>季度比較</u>	<u>二零零三年</u> <u>第三季</u>	<u>年度比較</u>
總經營開支	(29,972)	(25,091)	19.5%	(21,502)	39.4%
研究及開發	(20,688)	(13,533)	52.9%	(8,272)	150.1%
一般及行政	(3,831)	(6,019)	-36.3%	(8,896)	-56.9%
銷售及市場推廣	(1,899)	(1,940)	-2.1%	(2,747)	-30.9%
遞延股份報酬攤銷	(3,554)	(3,599)	-1.3%	(1,587)	123.9%

- 總經營開支上升至 30,000,000 元，較二零零四年第二季的 25,100,000 元錄得季度升幅 19.5%，並較二零零三年第三季的 21,500,000 元錄得年度升幅 39.4%。
- 研究及開發費用上升至 20,700,000 元，較上季的 13,500,000 元錄得季度升幅 52.9%，主要由於北京四廠非經常性工程開業成本和 90 納米的研究開發活動所致。

非經營專案

<u>以千美元計</u>	<u>二零零四年</u> <u>第三季</u>	<u>二零零四年</u> <u>第二季</u>	<u>季度比較</u>	<u>二零零三年</u> <u>第三季</u>	<u>年度比較</u>
其他收入(支出)	(3,195)	(2,225)	43.6%	2,672	-
利息收入	3,106	2,733	13.6%	1,563	98.7%
利息支出，扣除政府補貼	(3,614)	(2,760)	31.0%	(207)	1,645.9%
其他，淨額	(2,687)	(2,198)	22.2%	1,316	-
未發盈餘	-	-	-	(34,586)	-

- 二零零四年第三季其他非營業性損失 3,200,000 元主要是由於外匯變動中虧損的 3,600,000 元所致。
- 二零零四年三季利息收入增至 3,100,000 元，主要是由於利率上升而增加了利息收入。

3. 流動資金

<u>以千美元計</u>	<u>二零零四年第三季</u>	<u>二零零四年第二季</u>
現金及現金等價物	950,165	1,198,592
短期投資	90,823	90,464
應收賬款	187,235	131,708
存貨	134,757	113,563
其他	33,371	40,459
總流動資產	1,396,351	1,574,786
應付賬款	717,756	699,587
長期借款的即期部份	191,984	95,992
其他	85,245	54,443
總流動負債	994,985	850,022
現金比率	1.0x	1.4x
速動比率	1.3x	1.7x
流動比率	1.4x	1.9x

- 現金及現金等價物由 1,198,600,000 元降至 950,200,000 元，主要由於一、二、三、四廠和七廠發展的資本開支所致。

應收賬款／存貨的各日走勢

資本結構

<u>以千美元計</u>	<u>二零零四年第三季</u>	<u>二零零四年第二季</u>
現金及現金等價物	950,165	1,198,592
短期投資	90,823	90,464
短期借款	20,000	0
長期借款的即期部份	191,984	95,992
長期借款	544,454	413,965
總借款	756,438	509,957
現金淨額	284,550	779,099
股東權益	3,112,912	3,065,507
總借款對權益比率	24.3%	16.6%

- 總借款由二零零四年第二季的 510,000,000 元增至二零零四年第三季的 756,400,000 元。
- 總借款對權益比率由二零零四年第二季的 16.6% 上升至二零零四年第三季的 24.3%。

4. 現金流量及資本開支

<u>以千美元計</u>	<u>二零零四年第三季</u>	<u>二零零四年第二季</u>
收入淨額	39,343	34,165
折舊及攤銷	122,636	101,790
所購無形資產攤銷	3,508	3,532
現金變動淨額	(248,428)	(174,480)

資本開支計劃

- 計劃下的二零零四年資本開支增至約為 2,000,000,000 元。

5. 二零零四年第四季展望及指引

- 晶圓付運預期增加 15%--20%。
- 使用率預計在 94-99%。
- 綜合 ASP 預計下降 5-7%。
- 0.18 微米及以下的銷售百分比，包括銅接連件，預計有 4-7%的下降。
- 毛利率預計與二零零四年第三季相似。
- 經營開支相對銷售的百分比預計將升高百分之十幾。
- 資本開支約為 350,000,000 元至 400,000,000 元。
- 折舊及攤銷約為 150,000,000 元至 160,000,000 元。
- 遞延補償開支約為 7,000,000 元，其中約 4,000,000 元將於經營開支中扣賬及銷售成本為 3,000,000 元。

6. 近期公佈

- 股價及成交量不尋常波動和有關生產 90 納米芯片的報導。(二零零四年十月十日)
- 根據<上市規則>第 13.10 條附注(2)所規定的表格做出聲明。(二零零四年十月七日)
- 根據<上市規則>第 2.07(A)條及第 2.07(B)條發布公告。(二零零四年九月三十日)
- 中國大陸首座 12 英寸晶片長成功投產。(二零零四年九月二十五日)
- 中芯國際舉辦 2004 年技術研討會。(二零零四年九月三日)
- 發布截止二零零四年六月三十日止六個月中期報告。(二零零四年九月一日)
- 中芯國際成功開發出 0.18 微米高電壓單晶片 LCD 驅動晶片制程技術。(二零零四年八月二十七日)

- 中芯國際表示將對台积电的新起訴提出強有力辯護並呼籲公平友好的競爭。(二零零四年八月二十四日)
- MOSYS 公司的 IT- SRAM-R 技術成功通過中芯國際 0.13 微米制程檢驗。(二零零四年七月二十八日)
- 凸版印刷公司與中芯國際簽署建立合資公司協定 (二零零四年七月二十一日)
- 明導公司向中芯國際提供用於 0.18 微米混合信號制程的技術設計工具(TDK)和設計流程。(二零零四年七月八日)

上述公佈詳情請參閱中芯網站 www.smics.com。

中芯財務資料

合并資產負債表 (美元)

截至以下日期止三個月

資產負債表

	二零零四年九月三十日 (未經審核)	二零零四年六月三十日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	950,164,909	1,198,592,423
短期投資	90,823,297	90,463,911
應收賬款，已扣除撥備（二零零四年九月三十日為 421,681 元，二零零四年六月三十日為 356,826 元）	187,235,125	131,707,549
存貨	134,757,006	113,562,540
預付款項及其它流動資產	8,495,044	7,867,504
待售資產	24,875,320	32,591,632
流動資產合計	1,396,350,701	1,574,785,559
土地使用權，淨額	34,630,167	34,803,658
物業、廠房及設備總額	3,785,221,468	3,159,564,426
累計折舊	(623,572,186)	(501,436,777)
物業、廠房及設備，淨額	3,161,649,282	2,658,127,649
購入無形資產，淨額	59,720,325	61,777,449
資產合計	4,652,350,474	4,329,494,315
負債及股東權益		
流動負債：		
短期借款	20,000,000	-
長期借款的即期部份	191,983,707	95,991,900
應付賬款	717,756,459	699,586,755
預提費用及其它流動負債	65,244,711	54,443,275
流動負債合計	994,984,877	850,021,930

長期負債：		
長期借款	544,453,946	413,965,135
長期負債合計	544,453,946	413,965,135
負債合計	1,539,438,823	1,263,987,065
承諾		
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零四年九月三十日已發行股份為 18,228,120,120 股，未發行的股份為 18,224,817,010 股。	7,291,249	7,289,927
認股權證	50,297	124,920
額外繳入股本	3,291,017,646	3,294,693,501
應收股東票據	(876,911)	(1,891,580)
累計其他綜合盈餘	776,915	400,320
遞延股票報酬	(60,178,603)	(70,597,602)
累計虧絀	(125,168,942)	(164,512,236)
所有股東權益合計	3,112,911,651	3,065,507,250
總負債及股東權益合計	4,652,350,474	4,329,494,315

合并營運報表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零四年九月三十日 (未經審核)	二零零四年六月三十日 (未經審核)
銷售額	274,897,225	220,988,561
銷售成本	(199,163,928)	(156,952,228)
銷售成本—攤銷遞延股票報酬	(3,223,528)	(2,554,781)
毛利	72,509,769	61,481,552
經營費用：		
研究和開發	(20,688,265)	(13,532,637)
一般管理	(3,831,441)	(6,019,392)
銷售和市場推廣	(1,899,002)	(1,940,035)
攤銷遞延股票報酬*	(3,553,558)	(3,599,151)
經營費用總額	(29,972,266)	(25,091,215)
經營收入	42,537,503	36,390,337
其他收入（支出）：		
利息收入	3,107,173	2,732,629
利息支出	(3,614,187)	(2,759,605)
其他淨額	(2,687,195)	(2,197,963)
其他淨收入	(3,194,209)	(2,224,939)
收入淨額	39,343,294	34,165,398
視為就優先股派付的股息(1)	—	—
普通股持有人應占收入淨額	39,343,294	34,165,398

每股股份收入淨額，基本	0.0022	0.0019
每股美國預托股份收入淨額，基本(1)	0.1095	0.0955
每股股份收入淨額，攤薄	0.0022	0.0019
每股美國預托股份收入淨額，攤薄(1)	0.1079	0.0941
用作計算基本每股收入淨額的股份（以百萬計）	17,961	17,897
用作計算攤薄每股收入淨額的股份（以百萬計）	18,225	18,147
* 攤銷遞延股票報酬乃關於：		
研究和開發	1,346,112	1,301,740
一般和管理	1,667,791	1,671,587
銷售及市場推廣	539,655	625,824
總計	<u>3,553,558</u>	<u>3,599,151</u>

(1) 一股美國預托股份等於 50 股普通股。

合并现金流量表
(美元)

截至以下日期止三個月
二零零四年 二零零四年
九月三十日 六月三十日
(未經審核) (未經審核)

經營活動

普通股持有人應占收入	39,343,294	34,165,398
視為已派付優先股股息	—	—
收入淨額	<u>39,343,294</u>	<u>34,165,398</u>
收入淨額至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
出售廠房及設備的收益	(486,231)	20,676
呆賬撥備	64,855	280,391
折舊及攤銷	122,635,996	101,789,774
攤銷購入無形資產	3,507,555	3,531,649
攤銷遞延股票報酬	6,777,086	6,153,932
營運資產及負債的變動：		
應收賬款	(55,592,431)	(15,175,779)
存貨	(21,194,466)	(28,083,387)
預付款及其它流動資產	115,508	10,148,004
應付賬款	8,805,299	21,703,089
預扣費用及其它流動負債	15,264,958	7,876
經營活動所得現金淨額	<u>119,241,423</u>	<u>134,541,623</u>

投資活動

購買物業、廠房及設備	(617,011,320)	(351,833,464)
購買購入無形資產	(728,529)	(2,611,626)
購買短期投資	—	(64,132,303)
出售短期投資	—	1,005,977
出售長期投資	—	3,004,297
待售資產已收款項	3,025,118	1,530,794
出售廠房及設備收到款項	52,196	440,078

投資活動所耗現金淨額	(614,662,535)	(412,596,247)
融資活動		
長期借款所得款項	226,480,618	16,066,960
短期借款所得款項	20,000,000	—
行使雇員購股權所得款項	495,772	32,166,207
收取應收認購款項	—	93,000,000
已收股東按金變動	—	(37,772,810)
融資活動所得現金淨額	246,976,390	103,460,357
彙率變動的影響	17,208	114,441
現金及現金等價物減少淨額	(248,427,514)	(174,479,826)
現金及現金等價物—二零零四年四月一日（二零零四年七月一日）	1,198,592,423	1,373,072,249
現金及現金等價物—二零零四年六月三十日（二零零四年九月三十日）	950,164,909	1,198,592,423

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席及執行董事張汝京、非執行董事蔡來興、姚方（蔡來興的替任董事）、Sean Hunkler、獨立董事徐大麟、周延鵬、川西剛、蕭崇河、陳立武及王陽元。

承董事會命
中芯國際積體電路製造有限公司
主席
張汝京
香港，二零零四年十月二十八日

* 僅供識別